

S1C17 マニュアル 正誤表

項目			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C17001H2 User Manual (ICDmini Ver2.0)	411153404	4.1.1 ターゲット接続用コネクタ	14
同上	同上	8.3 S5U1C17001H 使用上の注意事項	32,33

(誤)

4.1.1 ターゲット接続用コネクタ

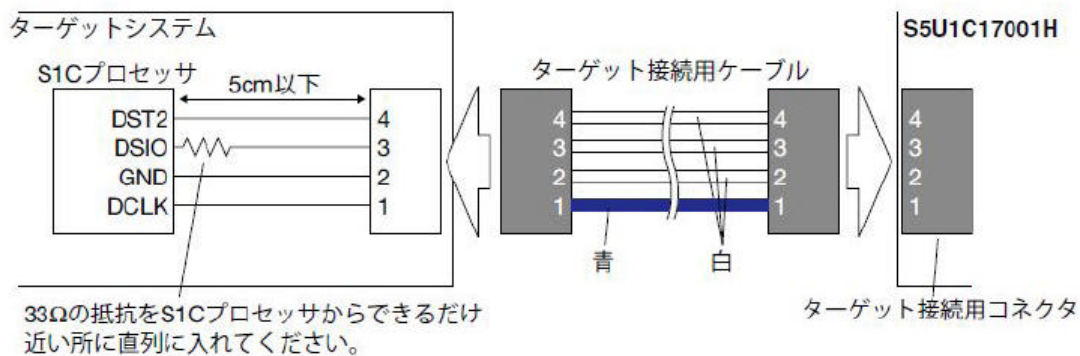


図 4.1.1.1 ターゲットシステムの接続

注：

- ターゲットのS1CプロセッサからS5U1C17001H接続用コネクタへのDSIO信号の配線には、S1CプロセッサのDSIO端子からできるだけ近い所に33Ωの抵抗を直列に入れてください。抵抗を接続しなくても動作可能ですが、誤動作を防ぐためには接続することを推奨します。その他の端子は直接接続します。

DSIO 端子に外部から Low レベルを入力することにより強制ブレークがかかり、S1Cプロセッサはデバッグモードに移行します。DSIO 端子は S1C プロセッサ内部の約 100kΩの抵抗でプルアップされていますが、デバッグ時以外には、33Ωを切り離してノイズ等の影響を少なくするか、チップ外部で VDD にプルアップすることを推奨します。

8.3 S5U1C17001H 使用上の注意事項

S1Cプロセッサからコネクタへの配線

ターゲットシステムの S1C プロセッサから S5U1C17001H 接続用コネクタへの配線の際、DSIO 端子に 33Ω の抵抗を S1C プロセッサからできるだけ近い所に直列に入れて接続してください。抵抗がなくても動作可能ですが、誤動作を防ぐためには接続することを推奨します。その他の端子は直接接続します。配線の全長は 5cm 以内としてください。DSIO は外部から Low を入力することにより強制ブレークがかかり、S1C プロセッサはデバッグモードに移行します。内部で約 $100k\Omega$ の抵抗でプルアップされていますが、デバッグ時以外は、 33Ω を切り離してノイズ等の影響を少なくするか、外部で V_{DD} にプルアップすることを推奨します。

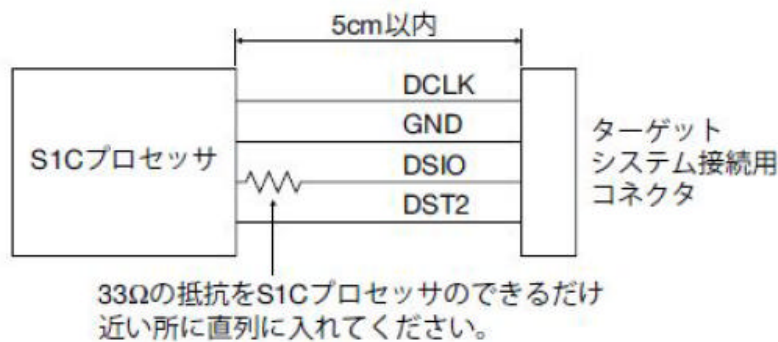


図 8.3.1 S1C プロセッサとターゲットシステム接続コネクタとの結線

(正)

4.1.1 ターゲット接続用コネクタ

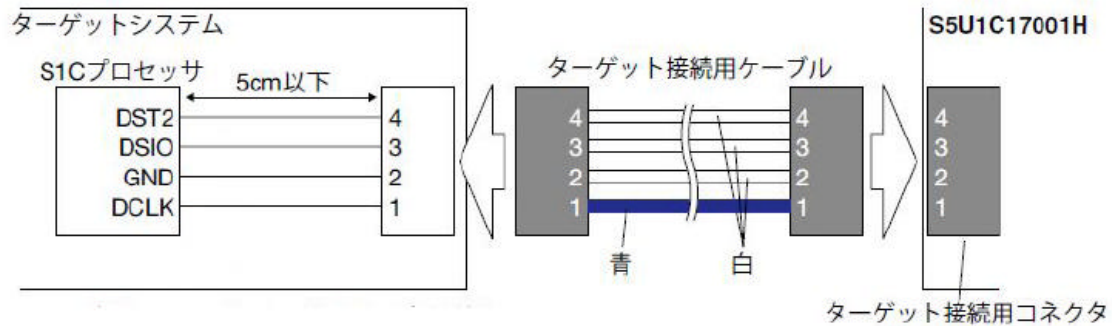


図 4.1.1.1 ターゲットシステムの接続

注：

- ・ターゲットシステムとの接続方法につきましては、各機種のテクニカルマニュアルを参照してください。

8.3 S5U1C17001H 使用上の注意事項

S1Cプロセッサからコネクタへの配線

ターゲットシステムとの接続方法につきましては、各機種のテクニカルマニュアルを参照してください。また、配線の全長は 5cm 以内としてください。

(図 8.3.1 削除)

S1C17 マニュアル 正誤表

項目			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C17001H2 User Manual (ICDmini Ver2.0)	411153404	8.3 S5U1C17001H 使用上の注意事項	33
(誤) 記載なし。			
(正) 本製品の置き方について 本製品は、ゴム足のある面を下にしてご使用ください。 付属品について USB ケーブルは本製品に付属されているものをご使用ください。 使用環境について 本製品は、屋内で使用してください。			

S1C17 マニュアル 正誤表

項目			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C17001H2 User Manual	411153404	7. ファームウェアアップデート	28
(誤)			
追記			
(正)			
(6) 現在のファームウェアバージョンを確認し、アップデートの必要があれば以下のコマンドを続けて入力してください。			
 S1C17 プロセッサ選択時			
(gdb) c17 fwe 0			
(gdb) c17 fwe 1			
(gdb) c17 firmupdate path¥filename.saf			
 S1C33 プロセッサ選択時			
(gdb) c33 firmupdate path¥filename.saf			
 path: 新しいファームウェアを置いたパス			
filename.saf: 新しいファームウェアのファイル名			
 コマンド入力後、以下が表示されれば完了です。			
 S1C17 プロセッサ選択時			
(gdb) c17 fwe 0			
Erase flash data ...done			
(gdb) c17 fwe 1			
Erase flash erase/write program ...done			
(gdb) c17 firmupdate path¥filename.saf			
Erase flash data ...done			
Load flash data done			
ICD firmware update ...done			
Please quit gdb, and power off ICD when LED2／LED3／LED4 is green.			
(LED is green in the case of SVT17701).			

S1C33プロセッサ選択時

(gdb) c33 firmupdate *path¥filename.saf*

Erase flash data ...done

Load flash data done

ICD firmware update ...done

Please quit gdb, and power off ICD when OK LED is on.

この作業には、1 5 分程度必要となる場合があります。

ファームウェアのアップデート中は絶対にS5U1C17001Hをリセットまたは、電源OFFにしないでください。

途中で中断した場合、S5U1C17001H が起動しなくなる可能性があります。

S1C17 マニュアル 正誤表

項目			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C17001H2 User Manual (ICDmini Ver2.0)	411153404	4.1.2.1 ターゲット用リセット信号出力 (TARGET RST OUT)	16
(誤) 4.1.2.1 ターゲット用リセット信号出力(TARGET RST OUT) このリセット出力を使用する場合は、以下のような回路構成を推奨します。 The diagram illustrates the recommended circuit for the Target Reset signal. On the left, the S5U1C17001H module is shown with its pin headers. Pin 3, labeled TARGET RST OUT, is connected to a target system. In the target system, this line passes through a pull-up resistor (プルアップ抵抗) and is connected to one input of an AND gate. The other input of the AND gate is connected to a reset switch (リセットスイッチ) located within the target system's reset circuit (ターゲットシステム上のリセット回路). The output of the AND gate is connected to the #RESET pin of the S1C processor (S1Cプロセッサ).			
図 4.1.2.1 ターゲトリセット回路図例			

4.1.2.1 ターゲット用リセット信号出力(TARGET RST OUT)

S5U1C17001H2

3.3V 1.8V

ターゲットから
入力された電源

ディップスイッチ
(SW4, SW5)で選択

10k Ω

ターゲットリセット信号

4 3 2 1

TARGET VCC IN

TARGET RST OUT

リセットパルスは以下のような波形になります。なお、ターゲットボードの負荷状況により、立ち上がり波形は変化しますので、注意してください。

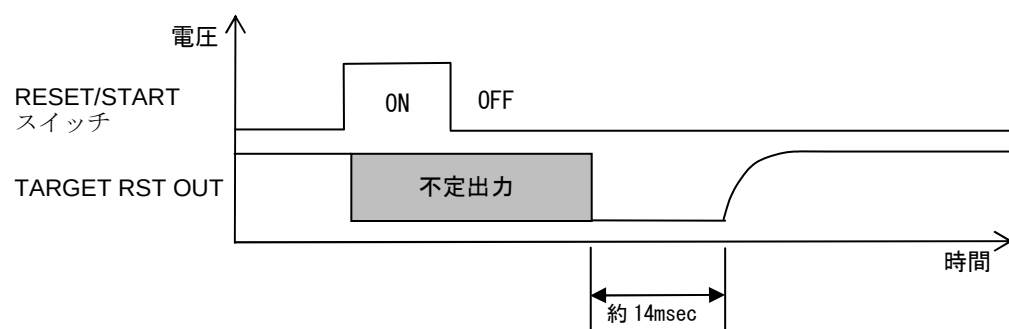


図 4.1.2.2(a) リセット端子出力波形

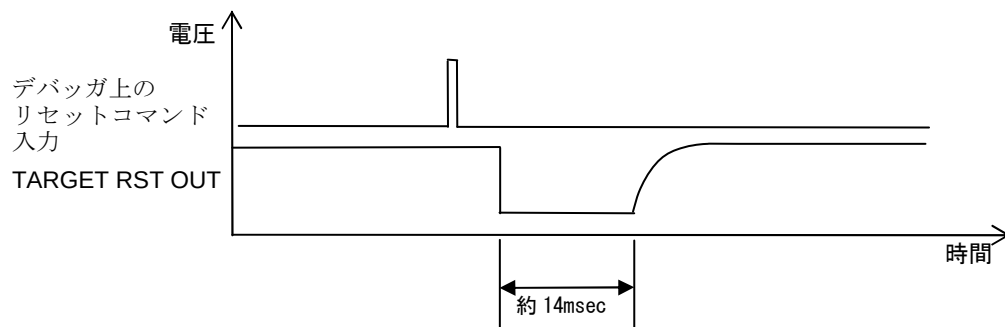


図 4.1.2.2(b) リセット端子出力波形

S1C17 マニュアル 正誤表

項目 S1C プロセッサ内で Flash プログラミング用電圧を生成する場合の注意事項			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C17001H2 User Manual (ICDmini Ver2.0)	411153404	4.1.2.3 Flash プログラミング用電圧出力(FLASH VCC OUT)	17
(誤) 注: Flash プログラミング用電圧の供給が必要か否かについては、各機種 of テクニカルマニュアルを参照 してください。テクニカルマニュアルに記載がない場合は、使用しないでください。過電圧により S1C プロセッサを破損する場合があります。			
(正) 注: Flash プログラミング用電圧の供給が必要か否かについては、各機種 of テクニカルマニュアルを参照 してください。テクニカルマニュアルに記載がない場合は、使用しないでください。過電圧により S1C プロセッサを破損する場合があります。 <u>また、S1C プロセッサ内で Flash プログラミング用電圧を生成する場合は、FLASH VCC OUT ピンと V_{PP} 端子を接続しないでください。</u>			

項目 S1C プロセッサ内で Flash プログラミング用電圧を生成する場合の注意事項			
対象マニュアル	発行 No.	項目	ページ
S5U1C17001H2 User Manual (ICDmini Ver2.0)	411153404	8.3 S5U1C17001H 使用上の注意事項	32
(誤)			
ターゲットシステムとの接続			
S5U1C17001H と接続される信号は非常に高速ですので、ターゲットシステム上に設けるコネクタの位置はターゲットの S1C プロセッサから 5cm 以内に設けるようにしてください。必要以上に S1C プロセッサから離すと正常に動作しない場合があります。また、S5U1C17001H とターゲットシステム の接続には、必ず付属の 4 ピンケーブルを使用してください。他のケーブルの使用は誤動作の原因になります。やむを得ず他のケーブルを使用せざるを得ない場合は、ターゲット接続用ケーブルを延長 せず、できるだけターゲットシステムの S1C プロセッサまでの距離が最短(20cm 以内)となるよう S5U1C17001H に直接ケーブルをつないでください。			
(正)			
ターゲットシステムとの接続			
S5U1C17001H と接続される信号は非常に高速ですので、ターゲットシステム上に設けるコネクタの位置はターゲットの S1C プロセッサから 5cm 以内に設けるようにしてください。必要以上に S1C プロセッサから離すと正常に動作しない場合があります。また、S5U1C17001H とターゲットシステム の接続には、必ず付属の 4 ピンケーブルを使用してください。他のケーブルの使用は誤動作の原因になります。やむを得ず他のケーブルを使用せざるを得ない場合は、ターゲット接続用ケーブルを延長 せず、できるだけターゲットシステムの S1C プロセッサまでの距離が最短(20cm 以内)となるよう S5U1C17001H に直接ケーブルをつないでください。 <u>また、Flash プログラミング用電圧を S1C プロセッサ内で生成する場合は、V_{PP} 端子と S5U1C17001H を接続しないでください。</u>			